

Title (en)
Induction component

Title (de)
Induktionsbauteil

Title (fr)
Composant à induction

Publication
EP 2383755 A1 20111102 (DE)

Application
EP 11163227 A 20110420

Priority
DE 102010028325 A 20100428

Abstract (en)
The component has a coil core (5) for holding a coil, and a flange i.e. plate, projected radially over a cylindrical coil core (4). A shielding ring surrounds the coil core with distance from the component. The shielding ring is connected together with the coil core, where an air gap is formed between the coil core and shielding ring at a position. A positioning unit is fixed between the flange and the shielding ring for correcting dimensions of the air gap. An inner shoulder is formed on an end corner of the shielding ring, where the end corner of the shielding ring faces to the flange.

Abstract (de)
Ein Bauelement zur Bildung eines Induktionsbauteils enthält einen Spulenkörper mit einem Kern und zwei an den jeweiligen axialen Enden des Kerns ausgebildeten radial vorspringenden Flanschen, von denen der eine Flansch zur Befestigung an einer Leiterplatte ausgebildet ist und größer ist als der andere Flansch. Der Spulenkörper ist an seiner Außenseite von einem Schirmring umgeben, der auf dem größeren der beiden Flansche auf sitzt. Hierzu hat der Schirmring an der unteren Stirnkante eine nach innen gerichtete Stufe, deren einer Schenkel eine Auflagefläche zur Auflage auf der Innenseite des Flanschs bildet. Der andere Schenkel bildet eine Anlagefläche zur Anlage an dem Außenrand des Flanschs. Die Stufe läuft vorzugsweise um den gesamten Umfang des Schirmrings herum. Dadurch wird ein zwischen dem oberen Flansch und der Innenseite des Schirmrings gebildeter Luftspalt in seiner Größe und Position festgelegt.

IPC 8 full level
H01F 27/36 (2006.01); **H01F 3/14** (2006.01); **H01F 17/04** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)
H01F 3/14 (2013.01 - EP KR US); **H01F 17/045** (2013.01 - EP KR US); **H01F 27/363** (2020.08 - EP KR US); **H01R 12/722** (2013.01 - EP KR US); **H01R 12/724** (2013.01 - KR); **H01R 13/6658** (2013.01 - EP US); **H01R 13/6666** (2013.01 - EP KR US); **H01R 25/00** (2013.01 - KR); **H01R 12/724** (2013.01 - EP US); **H01R 25/00** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)
• US 6847280 B2 20050125 - KUNG SAMUEL [US]
• DE 10212930 A1 20021121 - TOKIN CORP [JP]
• DE 102007063170 A1 20090625 - WUERTH ELEKTRONIK EISOS GMBH & [DE]

Citation (search report)
• [XY] US 2007018770 A1 20070125 - KAMIO YUICHI [JP]
• [YD] DE 102007063170 A1 20090625 - WUERTH ELEKTRONIK EISOS GMBH & [DE]
• [X] US 2006284716 A1 20061221 - YAMAGUCHI TAKAYUKI [JP]

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2383755 A1 20111102; EP 2383755 B1 20150318; AU 2011201441 A1 20111117; AU 2011201441 B2 20150528; BR PI1101734 A2 20150728; BR PI1101734 B1 20191210; CA 2737021 A1 20111028; CA 2737021 C 20171121; CN 102237180 A 20111109; CN 102237180 B 20160615; DE 102010028325 A1 20111103; ES 2534761 T3 20150428; HK 1163929 A1 20120914; IL 212235 A0 20110630; IL 212235 A 20141130; IL 212501 A0 20110731; JP 2011233871 A 20111117; KR 101757480 B1 20170712; KR 20110120243 A 20111103; MX 2011004388 A 20111027; PL 2383755 T3 20150831; RU 2011115985 A 20121027; RU 2569498 C2 20151127; US 2011267163 A1 20111103; US 8674801 B2 20140318

DOCDB simple family (application)
EP 11163227 A 20110420; AU 2011201441 A 20110330; BR PI1101734 A 20110426; CA 2737021 A 20110408; CN 201110108586 A 20110428; DE 102010028325 A 20100428; ES 11163227 T 20110420; HK 12104232 A 20120430; IL 21223511 A 20110410; IL 21250111 A 20110426; JP 2011082676 A 20110404; KR 20110039545 A 20110427; MX 2011004388 A 20110427; PL 11163227 T 20110420; RU 2011115985 A 20110425; US 201113088649 A 20110418